



性能特点

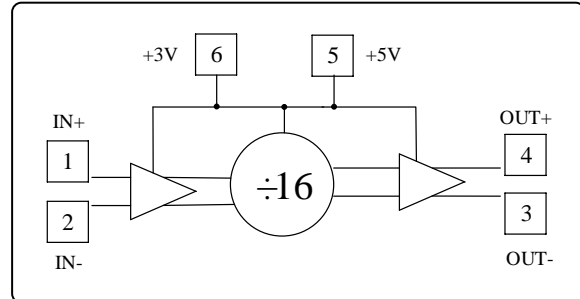
工作频段: 0.1-12 GHz

输出功率: 1 dBm

单电源供电: +5V/+3V @ 90 mA

芯片尺寸: 1.8 × 0.6 × 0.1 mm³

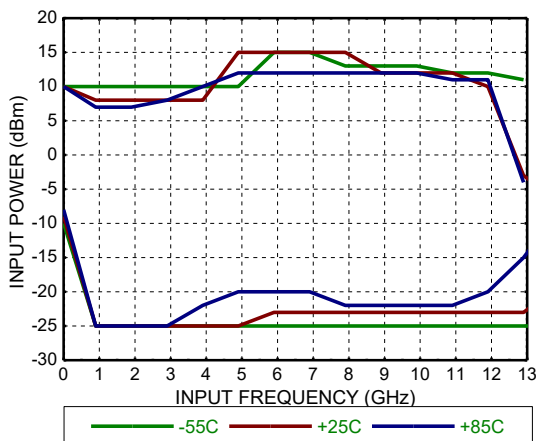
功能框图



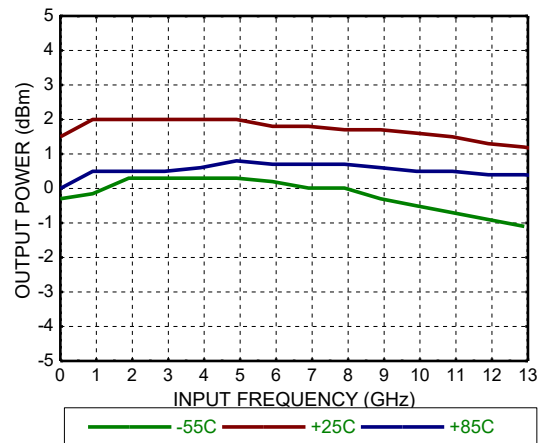
电特性参数 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = +5\text{ V}/+3\text{ V}$, $I_{DD} = 90\text{ mA}$)

参数	条件	最小	典型	最大	单位
最高输入频率	正弦波		12		GHz
最低输入频率	正弦波		0.1		GHz
输入功率范围	$f_{IN} = 0.1 - 12\text{ GHz}$	-25	0	+15	dBm
输出功率	$f_{IN} = 0.1 - 12\text{ GHz}$		1		dBm
单边带相位噪声	$P_{IN} = 0\text{ dBm}$, $f_{IN} = 3\text{ GHz}$		-150		dBc/Hz
工作电流	+5V/+3V		90		mA

输入灵敏度窗口 vs. 温度

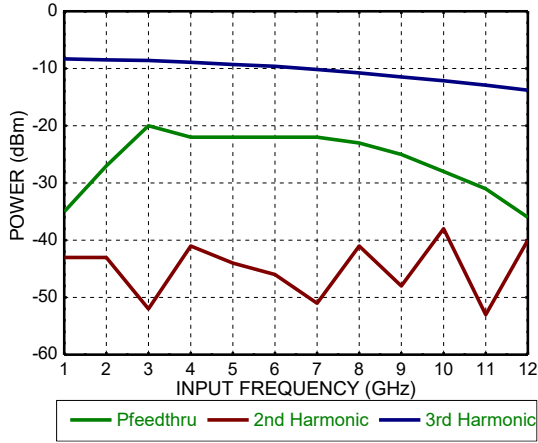


输出功率 vs. 温度

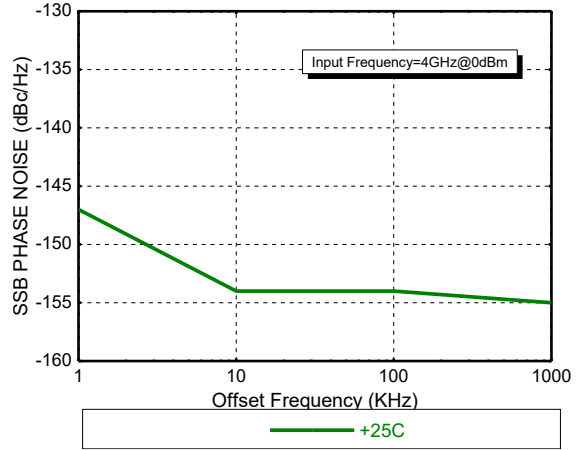




输出谐波, Pin=0dBm, T=25°C



SSB相位噪声, T=25°C

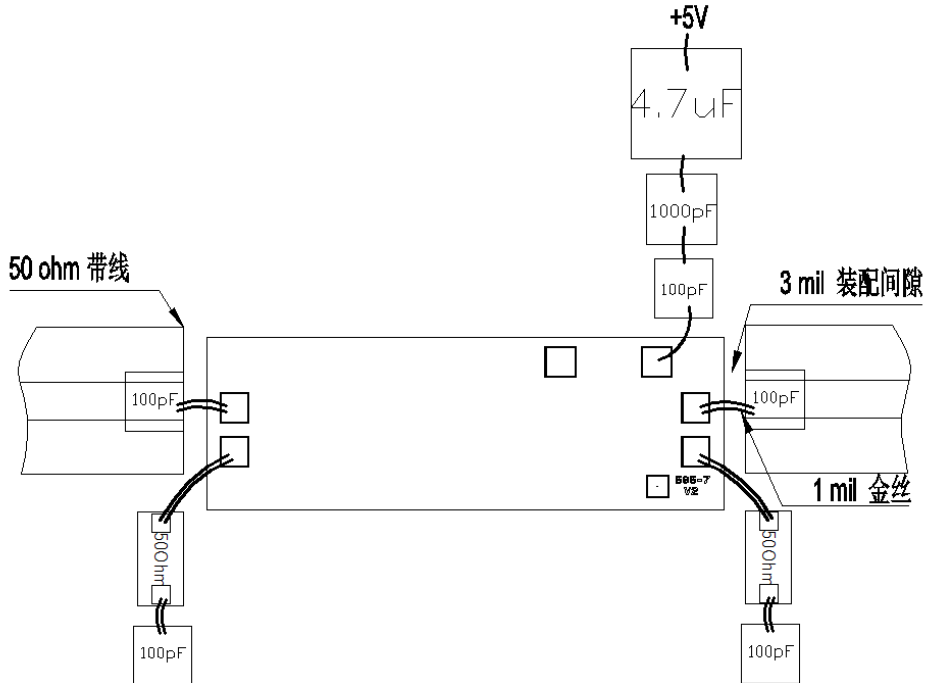


物理参数





装配图



注：该装配图为单端使用情况，如需差分使用，输入输出引脚均需接 100pF 隔直电容。

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN+	该焊盘是射频输入端（需外接 100pF 隔直电容）
2	IN-	该焊盘是射频输入端（单端使用时需外接 50ohm 电阻与 100pF 隔直电容到地）与焊盘 1 相位相差 180°
3	OUT-	该焊盘是分频信号输出端（单端使用时需外接 50ohm 电阻与 100pF 隔直电容到地）
4	OUT+	该焊盘是分频信号输出端（需外接 100pF 隔直电容）与焊盘 3 相位相差 180°
5	+5V	该焊盘是+5V 电源端，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容，+5V 与+3V 电源端只需使用其中一个
6	+3V	该焊盘是+3V 电源端，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容，+5V 与+3V 电源端只需使用其中一个
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至地

极限参数

供电电压：+5.5V（引脚 5）、+3.5V（引脚 6） 储存温度：-65~+150°C 工作温度：-55~+125°C